

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 光机电 >> 一种多芯片倒焊互联线列混成红外焦平面探测器

请输入查询关键词

科技频道

搜索

一种多芯片倒焊互联线列混成红外焦平面探测器

关键词: **倒焊 红外焦平面**

所属年份: 2002

成果类型: 应用技术

所处阶段: 初期阶段

成果体现形式: 新技术

知识产权形式: 发明专利

项目合作方式: 其他

成果完成单位: 中国科学院上海技术物理研究所

成果摘要:

本实用新型提供了一种线列焦平面器件多芯片倒焊互联新方法。其技术特点在于,在倒焊互联基板上制备金属薄膜引线电极,通过多芯片倒焊技术,把红外敏感元阵列芯片与读出电路分别倒焊在同一块倒焊互联基板上,利用基板上的金属薄膜引线完成光敏元与读出电路输入级的互联。本实用新型可用于线列红外焦平面器件的倒焊互联,具有使用灵活、热循环可靠性高的特点。

成果完成人: 张勤耀;王建新;何力

[完整信息](#)

行业资讯

- 塔北地区高精度卫星遥感数据处理
- 综合遥感技术在公路深部地质...
- 轻型高稳定度干涉成像光谱仪
- 智能化多用途无人机对地观测技术
- 稳态大视场偏振干涉成像光谱仪
- 2001年土地利用动态遥感监测
- 新疆特克斯河恰甫其海综合利...
- 用气象卫星资料反演蒸散
- 天水陇南滑坡泥石流遥感分析
- 综合机载红外遥感测量系统及...

成果交流

推荐成果

- [容错控制系统综合可信性分析...](#) 04-23
- [基于MEMS的微型高度计和微型...](#) 04-23
- [基于MEMS的载体测控系统及其...](#) 04-23
- [微机械惯性仪表](#) 04-23
- [自适应预估控制在大型分散控...](#) 04-23
- [300MW燃煤机组非线性动态模型...](#) 04-23
- [先进控制策略在大型火电机组...](#) 04-23
- [自动检测系统化技术的研究与应用](#) 04-23
- [机械产品可靠性分析--故障模...](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发